

GERMAN ENGINEERING MEETS SHANGHAI'S INNOVATION

# SHANGHAI SOMMERSCHOOL

## Intelligentes Design und Fertigung

14-tägiges chinesisch-deutsches Kultur- und Akademisches Austauschprogramm

### VERANSTALTER

Chinesisch-Deutsches Hochschulkolleg  
(CDHK)  
Tongji-Universität

*Gefördert von: Bildungskommission der Stadt  
Shanghai*

*Visafrei*

### ECKDATEN

ZEIT:  
23. August – 05. September 2026

ORT:  
Tongji-Universität, Shanghai

ANMELDESCHLUSS:  
30. Juni 2026

### PROGRAMM-HIGHLIGHTS

**Keine Anmeldegebühr, Kostenlose Unterkunft!  
Stipendien Verfügbar, Frühe Bewerber bevorzugt!**

- Akademische Vorträge & Laborbesichtigungen
- Chinesisch-Sprachkurse für Anfänger
- Unternehmungsbesichtigungen (ZPMC, SenseTime...)
- Deutsch-chinesischer Studentenaustausch
- Kulturelle Workshops: Kalligraphie, Teezeremonie
- Stadtbesichtigungen: Shanghai-Museum, Yu-Garten
- Abschlusszertifikat der Tongji-Universität
- Stipendien (Flugtickets der Economy Class) für 5 herausragende Teilnehmer.

**KOSTEN:** Keine Anmeldegebühr!

Die Kosten für das Rahmenprogramm der Summer School – einschließlich der Unterbringung in Doppelzimmern, Kursen und Besichtigungen – übernimmt der Veranstalter.

*Entdecken Sie die Zukunft der Robotik im Herzen von Shanghai!*



**ANMELDUNG**



### KONTAKT & ANMELDUNG

Begrenzte Teilnehmerzahl – die Anmeldung schließt, sobald alle Plätze vergeben sind. Bitte prüfen Sie Ihren Posteingang auf eine Bestätigungs-E-Mail.

WU Ruiming  
615kevin@tongji.edu.cn

Prof. Dr. TANG Qirong  
qirong.tang@tongji.edu.cn

Prof. Dr. Michael Abramovici  
michael.abramovici@ruhr-uni-bochum.de

Dr. GAO Linchong  
lingchong.gao@tum.de